



平成25年3月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)

平成24年10月31日

上場会社名 東京エレクトロン株式会社
 コード番号 8035 URL <http://www.tel.co.jp>
 代表者 (役職名) 代表取締役社長
 問合せ先責任者 (役職名) 取締役 執行役員
 四半期報告書提出予定日 平成24年11月8日
 四半期決算補足説明資料作成の有無 : 有
 四半期決算説明会開催の有無 : 有 (機関投資家・アナリスト向け)

(氏名) 竹中 博司
 (氏名) 原田 芳輝
 配当支払開始予定日

TEL 03-5561-7000
 平成24年12月3日

上場取引所 東

(百万円未満切捨て)

1. 平成25年3月期第2四半期の連結業績(平成24年4月1日～平成24年9月30日)

(1) 連結経営成績(累計)

(%表示は、対前年同四半期増減率)

	売上高		営業利益		経常利益		四半期純利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%
25年3月期第2四半期	266,600	△18.3	12,202	△66.9	15,459	△61.1	6,090	△77.2
24年3月期第2四半期	326,350	2.5	36,859	△12.9	39,722	△11.9	26,657	△20.3

(注) 包括利益 25年3月期第2四半期 1,898百万円 (△90.5%) 24年3月期第2四半期 20,048百万円 (△29.9%)

	1株当たり四半期純利益	潜在株式調整後1株当たり四半期純利益
	円 銭	円 銭
25年3月期第2四半期	33.99	33.94
24年3月期第2四半期	148.85	148.63

(2) 連結財政状態

	総資産	純資産	自己資本比率
	百万円	百万円	%
25年3月期第2四半期	745,079	595,670	78.3
24年3月期	783,610	598,602	74.9

(参考) 自己資本 25年3月期第2四半期 583,700百万円 24年3月期 586,789百万円

2. 配当の状況

	年間配当金				
	第1四半期末	第2四半期末	第3四半期末	期末	合計
	円 銭	円 銭	円 銭	円 銭	円 銭
24年3月期	—	53.00	—	27.00	80.00
25年3月期	—	25.00	—	—	—
25年3月期(予想)	—	—	—	26.00	51.00

(注) 直近に公表されている配当予想からの修正の有無 : 無

平成25年3月期の第2四半期末配当金の内訳は、普通配当15円、記念配当10円です。
 平成25年3月期の期末配当金の内訳は、普通配当16円、記念配当10円です。

3. 平成25年3月期の連結業績予想(平成24年4月1日～平成25年3月31日)

(%表示は、対前期増減率)

	売上高		営業利益		当期純利益		1株当たり当期純利益
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	円 銭
通期	501,000	△20.9	12,500	△79.3	7,000	△80.9	39.07

(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 : 有

※ 注記事項

(1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動(連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動) : 無

(2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 : 有

詳細は、【添付資料】6ページ「2. サマリー情報(注記事項)に関する事項 (2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用」をご覧ください。

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

- ① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更 : 有
- ② ①以外の会計方針の変更 : 無
- ③ 会計上の見積りの変更 : 有
- ④ 修正再表示 : 無

第1四半期より減価償却方法の変更を行っており、「会計方針の変更を会計上の見積りの変更と区別することが困難な場合」に該当しております。詳細は、【添付資料】6ページ「2. サマリー情報(注記事項)に関する事項 (3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示」をご覧ください。

(4) 発行済株式数(普通株式)

① 期末発行済株式数(自己株式を含む)	25年3月期2Q	180,610,911 株	24年3月期	180,610,911 株
② 期末自己株式数	25年3月期2Q	1,435,138 株	24年3月期	1,446,079 株
③ 期中平均株式数(四半期累計)	25年3月期2Q	179,172,561 株	24年3月期2Q	179,086,953 株

※四半期レビュー手続の実施状況に関する表示

この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく四半期レビュー手続の対象外であり、この四半期決算短信の開示時点において、金融商品取引法に基づく四半期財務諸表のレビュー手続は終了していません。

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

・本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、その達成を当社として約束する趣旨のものではありません。また、実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。業績予想の前提となる条件及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等については、【添付資料】5ページ「1. 当四半期決算に関する定性的情報 (3) 連結業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。

・当社は、平成24年10月31日に機関投資家・アナリスト向け説明会を開催する予定です。この説明会で配布する決算説明資料につきましては、開催と同時に当社ホームページに掲載する予定です。

【添付資料】

[目次]

1. 当四半期決算に関する定性的情報	2
(1) 連結経営成績に関する定性的情報	2
(2) 連結財政状態に関する定性的情報	4
(3) 連結業績予想に関する定性的情報	5
2. サマリー情報(注記事項)に関する事項	6
(1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動	6
(2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用	6
(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示	6
3. 四半期連結財務諸表	7
(1) 四半期連結貸借対照表	7
(2) 四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書	8
(3) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書	10
(4) 継続企業の前提に関する注記	11
(5) セグメント情報等	11
(6) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記	11

1. 当四半期決算に関する定性的情報

(1) 連結経営成績に関する定性的情報

当第2四半期連結累計期間においては、欧州債務問題の長期化や米国の財政緊縮などによって不確実性が高まるなか、中国をはじめとする新興国経済の成長も鈍化するなど、世界的な景気減速懸念が広がっております。また、日本においても、このような世界経済の不透明感を背景に、景気回復の動きが停滞しております。

当社グループの参画しておりますエレクトロニクス産業に関しましては、パソコンやテレビの販売がまだまだ低調であり、スマートフォン及びタブレットPCの需要に依存している状況です。堅調なスマートフォンに関しても、一部機種の販売動向によって電子部品市況は大きく左右され、電子部品市場を本格的に牽引するまでには至っておりません。

このような状況のもと、当第2四半期連結累計期間の連結業績は、売上高2,666億円(前年同期比18.3%減)、営業利益122億2百万円(前年同期比66.9%減)、経常利益154億5千9百万円(前年同期比61.1%減)、また、四半期純利益は60億9千万円(前年同期比77.2%減)となりました。

セグメント別の概況は以下のとおりです。

① 半導体製造装置

世界的な景気減速によりパソコンの販売が低調に推移しているうえ、スマートフォンやタブレットPCに関しましても、当初の期待の伸びには届かない見通しです。その結果、DRAMの需給改善は進まず、また、フラッシュメモリーの需要も伸び悩んでおります。一部のロジック系半導体向け先端設備投資は行われているものの、メモリー向け設備投資は引き続き低調に推移しており、半導体製造装置市場は全般的に調整局面が続いております。このような状況のもと、当セグメントの当第2四半期連結累計期間の外部顧客に対する売上高は、2,146億6千6百万円(前年同期比13.6%減)となりました。

② FPD/PV (フラットパネルディスプレイ及び太陽光パネル) 製造装置

スマートフォン向け高機能の中小型液晶パネルは伸びているものの、テレビ販売は買い替え需要の停滞から抜け出せず、パソコン販売も低迷が続いております。このような状況のもと、液晶パネル用製造装置の需要は低調に推移し、当セグメントの当第2四半期連結累計期間の外部顧客に対する売上高は、92億3千万円(前年同期比74.8%減)となりました。

③ 電子部品・情報通信機器

電子部品事業においては、デジタル家電関連製品及び産業機器関連製品の需要が停滞している一方、海外での販売が伸長したことや、商権の拡大が売上に寄与したことにより増収となりました。また、クラウドコンピューティングの浸透に伴い、情報通信機器関連の製品販売及び保守サービスが堅調に推移しました。このような状況のもと、当セグメントの当第2四半期連結累計期間の外部顧客に対する売上高は、424億6千5百万円(前年同期比3.5%増)となりました。

④ その他

当セグメントの当第2四半期連結累計期間の外部顧客に対する売上高は、2億3千8百万円(前年同期比1.4%減)となりました。

(ご参考)

【連結業績】

(単位：百万円)

	前期上半期	前期下半期
売上高	326,350	306,740
半導体製造装置	248,394	229,479
日本	50,365	32,522
米国	53,579	61,242
欧州	30,988	18,337
韓国	37,883	70,856
台湾	44,163	30,854
中国	15,800	9,594
東南アジア他	15,613	6,070
F P D / P V 製造装置	36,677	33,211
電子部品・情報通信機器	41,037	43,830
その他	241	219
営業利益	36,859	23,584
経常利益	39,722	24,324
四半期純利益	26,657	10,067

当期上半期	当期	
	第1Q	第2Q
266,600	134,179	132,421
214,666	108,703	105,963
20,218	10,032	10,186
55,782	26,629	29,152
23,402	10,457	12,944
38,677	24,214	14,463
58,795	29,338	29,456
11,863	5,666	6,196
5,927	2,363	3,563
9,230	4,769	4,460
42,465	20,605	21,859
238	101	137
12,202	9,283	2,918
15,459	11,248	4,211
6,090	5,720	370

(注) セグメント間取引については、相殺消去しております。

【生産及び受注の実績】

1. 生産実績

(単位：百万円)

	前期上半期	前期下半期
半導体製造装置	232,433	219,931
F P D / P V 製造装置	29,957	25,898
合計	262,390	245,829

当期上半期	当期	
	第1Q	第2Q
184,976	96,681	88,294
6,633	2,121	4,511
191,609	98,803	92,806

(注) 1. 金額は販売価格によっております。
2. 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

2. 受注実績(受注高)

(単位：百万円)

	前期上半期	前期下半期
半導体製造装置	186,224	251,390
F P D / P V 製造装置	10,633	7,964
電子部品・情報通信機器	42,092	42,183
その他	241	219
合計	239,192	301,758

当期上半期	当期	
	第1Q	第2Q
142,957	76,029	66,928
10,914	2,829	8,085
43,290	22,631	20,658
238	101	137
197,401	101,590	95,810

(注) 1. セグメント間取引については、相殺消去しております。
2. 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

3. 受注実績(受注残高)

(単位: 百万円)

	前期第2Q末	前期期末	当期第1Q末	当期第2Q末
半導体製造装置	166,773	188,684	157,737	118,702
F P D / P V 製造装置	39,447	14,200	12,260	15,885
電子部品・情報通信機器	15,430	13,783	15,809	14,608
その他	—	—	—	—
合計	221,651	216,669	185,807	149,196

(注) 1. セグメント間取引については、相殺消去しております。

2. 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

(2) 連結財政状態に関する定性的情報

① 財政状態

当第2四半期連結会計期間末の流動資産は、前連結会計年度末に比べ558億3千5百万円減少し、5,512億1千5百万円となりました。主な内容は、受取手形及び売掛金の減少553億2千1百万円、たな卸資産の減少164億8千万円、有価証券に含まれる短期投資の増加332億9百万円によるものであります。

有形固定資産は、前連結会計年度末から2億6千2百万円増加し、1,271億4千7百万円となりました。

無形固定資産は、のれんの増加151億3千4百万円などにより、前連結会計年度末から151億5千万円増加し、198億5千4百万円となりました。

投資その他の資産は、前連結会計年度末から18億9千1百万円増加し、468億6千2百万円となりました。

これらの結果、総資産は、前連結会計年度末から385億3千1百万円減少し、7,450億7千9百万円となりました。

流動負債は、前連結会計年度末に比べ365億5千1百万円減少し、882億4千2百万円となりました。主として、支払手形及び買掛金の減少140億8千9百万円、前受金の減少130億1千万円によるものであります。

固定負債は、前連結会計年度末に比べ9億5千2百万円増加し、611億6千6百万円となりました。

純資産は、前連結会計年度末に比べ29億3千2百万円減少し、5,956億7千万円となりました。主として、四半期純利益60億9千万円を計上したことによる増加、前期の期末配当48億3千7百万円の実施による減少、円高の影響による為替換算調整勘定の減少24億4千4百万円、その他有価証券評価差額金の減少19億9千3百万円によるものであります。この結果、自己資本比率は78.3%となりました。

② キャッシュ・フロー

現金及び現金同等物の当第2四半期連結会計期間末残高は、前連結会計年度末に比べ171億2千5百万円減少し、1,416億5千1百万円となりました。なお、現金及び現金同等物に含まれていない満期日又は償還日までの期間が3ヶ月を超える定期預金及び短期投資1,445億6千8百万円を加えた残高は、前連結会計年度末に比べ385億9千4百万円増加し、2,862億1千9百万円となりました。当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況は、次のとおりであります。

営業活動により獲得したキャッシュ・フローにつきましては、前年同期に比べ472億9百万円増加し、739億2千万円となりました。主な要因につきましては、税金等調整前四半期純利益155億3千9百万円、売上債権の減少546億1千5百万円、たな卸資産の減少148億3千6百万円がそれぞれキャッシュ・フローの収入となり、仕入債務の減少143億1千9百万円、前受金の減少123億1千8百万円がキャッシュ・フローの支出となったことによるものであります。

投資活動により支出したキャッシュ・フローにつきましては、主として連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出158億3千万円、有形固定資産の取得による支出118億1千1百万円、短期投資の増加504億9千9百万円により、前年同期の724億8千9百万円に対し842億1千8百万円となりました。

財務活動により支出したキャッシュ・フローにつきましては、主に配当金の支払48億3千7百万円により、前年同期の167億5千万円に対し64億7千3百万円となりました。

(3) 連結業績予想に関する定性的情報

世界経済の先行きが不透明な環境のもと、半導体メーカーの設備投資においては、本格的な回復に若干の時間を要する見込みであります。このような状況から、当社主力部門である半導体製造装置の受注も軟調に推移しており、売上が前回予想を下回る見込みとなったため、平成24年7月30日に公表した通期の連結業績予想を修正いたします。

平成25年3月期の連結業績予想

	通期予想
売上高	5,010億円 (前年同期比20.9%減)
半導体製造装置	3,930億円 (前年同期比17.8%減)
FPD/PV製造装置	190億円 (前年同期比72.8%減)
電子部品・情報通信機器	885億円 (前年同期比 4.3%増)
その他	5億円 (前年同期比 8.4%増)
営業利益	125億円 (前年同期比79.3%減)
当期純利益	70億円 (前年同期比80.9%減)

(注) セグメント間取引については、相殺消去しております。

※この決算短信に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、国内及び諸外国の経済状況、各種通貨の為替レートの変動、業績に影響を与えるその他の要因等現時点で入手可能な情報をもとに、当社グループが合理的であると判断した一定の前提に基づいており、当社としてその実現を約束する趣旨のものではありません。これらは、市況、競争状況、新製品の導入及びその成否、並びに半導体関連業界の世界的な状況を含む多くの不確実な要因の影響を受けます。

従って、実際の売上高及び利益は、この決算短信に記載されている予想数値とは大きく異なる場合がありますことをご承知おきください。

2. サマリー情報(注記事項)に関する事項

(1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動

該当事項はありません。

(2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

税金費用の計算

当社及び一部の連結子会社は、当連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算する方法を採用しております。

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

会計上の見積りの変更と区別することが困難な会計方針の変更

当社及び国内連結子会社は、法人税法の改正に伴い、第1四半期連結会計期間より、平成24年4月1日以後に取得した有形固定資産については、改正後の法人税法に基づく減価償却の方法に変更しております。これによる損益に与える影響は軽微であります。

3. 四半期連結財務諸表
 (1) 四半期連結貸借対照表

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (平成24年3月31日)	当第2四半期連結会計期間 (平成24年9月30日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	35,834	41,219
受取手形及び売掛金	150,305	94,983
有価証券	211,790	245,000
商品及び製品	101,789	92,464
仕掛品	35,104	27,241
原材料及び貯蔵品	12,575	13,283
その他	61,026	37,869
貸倒引当金	△1,376	△847
流動資産合計	607,050	551,215
固定資産		
有形固定資産	126,885	127,147
無形固定資産		
のれん	—	15,134
その他	4,703	4,719
無形固定資産合計	4,703	19,854
投資その他の資産		
その他	48,819	50,559
貸倒引当金	△3,848	△3,697
投資その他の資産合計	44,971	46,862
固定資産合計	176,560	193,864
資産合計	783,610	745,079
負債の部		
流動負債		
支払手形及び買掛金	46,986	32,897
製品保証引当金	8,903	7,979
その他の引当金	9,077	6,698
その他	59,826	40,667
流動負債合計	124,794	88,242
固定負債		
退職給付引当金	54,646	55,559
その他の引当金	619	571
その他	4,947	5,034
固定負債合計	60,213	61,166
負債合計	185,007	149,409
純資産の部		
株主資本		
資本金	54,961	54,961
資本剰余金	78,023	78,023
利益剰余金	471,186	472,429
自己株式	△9,747	△9,670
株主資本合計	594,422	595,743
その他の包括利益累計額		
その他有価証券評価差額金	3,575	1,582
繰延ヘッジ損益	△51	△22
為替換算調整勘定	△11,157	△13,602
その他の包括利益累計額合計	△7,633	△12,042
新株予約権	1,156	1,251
少数株主持分	10,656	10,718
純資産合計	598,602	595,670
負債純資産合計	783,610	745,079

(2) 四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書
四半期連結損益計算書
第2四半期連結累計期間

(単位：百万円)

	前第2四半期連結累計期間 (自 平成23年4月1日 至 平成23年9月30日)	当第2四半期連結累計期間 (自 平成24年4月1日 至 平成24年9月30日)
売上高	326,350	266,600
売上原価	212,807	180,963
売上総利益	113,543	85,637
販売費及び一般管理費		
研究開発費	41,148	37,417
その他	35,534	36,017
販売費及び一般管理費合計	76,683	73,434
営業利益	36,859	12,202
営業外収益		
その他	3,096	3,385
営業外収益合計	3,096	3,385
営業外費用		
閉鎖拠点維持管理費用	68	34
その他	164	93
営業外費用合計	233	127
経常利益	39,722	15,459
特別利益		
固定資産売却益	12	283
償却債権取立益	1,437	—
その他	171	—
特別利益合計	1,621	283
特別損失		
固定資産除売却損	212	63
災害による損失	938	—
事業再編損失	—	132
投資有価証券評価損	811	—
その他	155	7
特別損失合計	2,118	203
税金等調整前四半期純利益	39,225	15,539
法人税等	12,242	7,057
過年度法人税等	—	2,194
少数株主損益調整前四半期純利益	26,983	6,287
少数株主利益	325	196
四半期純利益	26,657	6,090

四半期連結包括利益計算書
第2四半期連結累計期間

(単位：百万円)

	前第2四半期連結累計期間 (自 平成23年4月1日 至 平成23年9月30日)	当第2四半期連結累計期間 (自 平成24年4月1日 至 平成24年9月30日)
少数株主損益調整前四半期純利益	26,983	6,287
その他の包括利益		
その他有価証券評価差額金	△1,924	△1,993
繰延ヘッジ損益	51	78
為替換算調整勘定	△5,061	△2,474
その他の包括利益合計	△6,935	△4,388
四半期包括利益	20,048	1,898
(内訳)		
親会社株主に係る四半期包括利益	19,744	1,681
少数株主に係る四半期包括利益	303	217

(3) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：百万円)

	前第2四半期連結累計期間 (自 平成23年4月1日 至 平成23年9月30日)	当第2四半期連結累計期間 (自 平成24年4月1日 至 平成24年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー		
税金等調整前四半期純利益	39,225	15,539
減価償却費	10,523	11,789
退職給付引当金の増減額 (△は減少)	1,320	919
賞与引当金の増減額 (△は減少)	△359	△1,996
製品保証引当金の増減額 (△は減少)	699	△832
受取利息及び受取配当金	△491	△847
売上債権の増減額 (△は増加)	2,446	54,615
たな卸資産の増減額 (△は増加)	6,013	14,836
仕入債務の増減額 (△は減少)	△10,198	△14,319
未収消費税等の増減額 (△は増加)	10,671	10,118
未払消費税等の増減額 (△は減少)	△2,610	△25
前受金の増減額 (△は減少)	891	△12,318
その他	△2,700	△2,320
小計	55,430	75,156
利息及び配当金の受取額	425	651
利息の支払額	△18	△20
法人税等の支払額又は還付額 (△は支払)	△29,126	△1,867
営業活動によるキャッシュ・フロー	26,711	73,920
投資活動によるキャッシュ・フロー		
定期預金の増減額 (△は増加)	5,000	△5,227
短期投資の増減額 (△は増加)	△60,499	△50,499
有形固定資産の取得による支出	△15,175	△11,811
有形固定資産の売却による収入	94	1,536
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	—	△15,830
事業譲受による支出	—	△1,097
その他	△1,908	△1,287
投資活動によるキャッシュ・フロー	△72,489	△84,218
財務活動によるキャッシュ・フロー		
短期借入金の純増減額 (△は減少)	△2,844	△1,308
配当金の支払額	△13,608	△4,837
その他	△297	△328
財務活動によるキャッシュ・フロー	△16,750	△6,473
現金及び現金同等物に係る換算差額	△1,416	△352
現金及び現金同等物の増減額 (△は減少)	△63,945	△17,125
現金及び現金同等物の期首残高	165,050	158,776
現金及び現金同等物の四半期末残高	101,104	141,651

(4) 継続企業の前提に関する注記

該当事項はありません。

(5) セグメント情報等

① 報告セグメントの概要

当社の報告セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、経営者が、経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。

当社は、BU(ビジネスユニット)を基礎とした製品・サービス別のセグメントから構成されており、「半導体製造装置」、「FPD/PV(フラットパネルディスプレイ及び太陽光パネル)製造装置」及び「電子部品・情報通信機器」を報告セグメントとしております。

「半導体製造装置」の製品は、ウェーハ処理工程で使われるコータ/デベロッパ、プラズマエッチング装置、熱処理成膜装置、枚葉成膜装置、洗浄装置、ウェーハ検査工程で使われるウェーハプローバ及びその他半導体製造装置から構成されており、これらの開発・製造・販売・保守サービス等を行っております。

「FPD/PV製造装置」の製品は、フラットパネルディスプレイ製造用のコータ/デベロッパ、プラズマエッチング/アッシング装置及び薄膜シリコン太陽光パネル製造用のプラズマCVD装置から構成されており、これらの開発・製造・販売・保守サービス等を行っております。

「電子部品・情報通信機器」は、集積回路(IC)を中心とした半導体製品、その他電子部品、コンピュータ・ネットワーク機器、ソフトウェア等の設計・開発・仕入・販売等を行っております。

② 報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

当第2四半期連結累計期間(自平成24年4月1日至平成24年9月30日)

(単位:百万円)

	報告セグメント			その他 (注) 1	合計	調整額 (注) 2	四半期連結損益 計算書計上額 (注) 3
	半導体 製造装置	FPD/PV 製造装置	電子部品・ 情報通信機器				
売上高	214,681	9,230	42,866	5,890	272,669	△6,068	266,600
セグメント利益 又は損失(△)	30,782	△3,366	677	776	28,870	△13,330	15,539

- (注) 1. 「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、当社グループの物流、施設管理及び保険業務等を含んでおります。
2. セグメント利益又は損失の調整額△13,330百万円には、各報告セグメントに配分していない全社費用が含まれております。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない当社における基礎研究又は要素研究等の研究開発費△10,247百万円であります。
3. セグメント利益又は損失は、四半期連結損益計算書の税金等調整前四半期純利益と調整を行っております。

③ 報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

(固定資産に係る重要な減損損失)

該当事項はありません。

(のれんの金額の重要な変動)

該当事項はありません。

(重要な負ののれん発生益)

該当事項はありません。

(6) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

該当事項はありません。